

電子部品用、配線パターン、一般用無電解ニッケル－ボロンめっき薬品 (Ni-B)

商品名	特徴	品番・作業条件	荷姿	用途
ニボロンM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni-B 連続使用 ● 耐熱、耐変色性がよい ● 電気抵抗が小さい ● はんだ付け、Ag-Cu口ウ付けに最適 ● シンター後の特性がよい ○ 弊社Pd活性化液AT-90シリーズとの組合せで抜群の性能を発揮 ○ Naレス 	ニボロン M 原液使用 ニボロン A 建浴 ニボロン B 補給 60°C	20L 200L	<ul style="list-style-type: none"> ○ CPUセラミックICパッケージ ● 半導体部品 ● 微細パターン50μm以下 ● ワイヤーボンディング ● 電極形成 ● 放熱板(Cu-W) ● 光コネクターパッケージ ● HTCC基板(Wペースト) ☆ ベストセラー
ニボロン5	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni-B 連続使用 ● ニッケル皮膜100% ● 電気Niと同様の結晶構造 ● はんだ付け、Ag-Cu口ウ付けが最高 ● 耐熱、耐変色性がすぐれる ● 最も活性なめっき液、どんな物にもめっきができる ● めっき温度が低い(35°C~) ● 無電解ストライクめっき ● ボイドフリー 	ニボロン 5M 建浴 ニボロン 5B 補給 ニボロン 5A 補給 35 ~ 60°C	20L	<ul style="list-style-type: none"> ○ 電子部品 ● ハーメチックシール部品 ● 各種ペースト上のめっき ● 繊維上のめっき ● 微粉上のめっき ● サーミスター ● リード端子 ● 放熱板(Cu合金)
ニボロン70	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni-B 連続使用 ● 耐熱性がよい ● 大気中で加熱後(650°C)もはんだ付け性がよい ● はんだ付け、Ag-Cu口ウ付けに最適 ● 電気抵抗が小さい ● 連続使用浴でコストが安い 	ニボロン 70S 建浴 ニボロン 70M 建浴 ニボロン 70R 補給 60°C	20L 100L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックパッケージ ● 半導体部品、電子部品 ● 微細パターン ● ワイヤーボンディング ● 電極形成 ● 放熱板(OFC, SiCA) ● 自動車部品
ニボロン80	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ni-B 連続使用 ● 耐熱、耐変色性がよい ● 電気抵抗が小さい ● はんだ付け、Ag-Cu口ウ付けに最適 ● 連続使用浴でコストが安い 	ニボロン 80S 建浴 ニボロン 80M 建浴 ニボロン 80R 補給 60°C	20L 100L	<ul style="list-style-type: none"> ○ セラミックパッケージ ● 半導体部品、電子部品 ● 微細パターン ● ワイヤーボンディング ● 自動車部品
ニボロン946	<ul style="list-style-type: none"> ■ ボロンのコンテンツが高い ● 耐熱性、耐酸化皮膜用 ● Bコンテンツ4%以上 	原液使用	20L	<ul style="list-style-type: none"> ● 耐熱部品